**FCM5低发热环氧王**

**使用说明书**

1. 介绍

低发热环氧王是一种粘度特别低的快速固化的环氧树脂镶嵌料;

冷镶嵌料硬化后具有良好的透明性；

该材料，不仅能满足各种无机材料样品的镶嵌；

由于其在固化过程中，收缩小，发热少，温度低，可用于**有机材料样品**，如线路板等样品的镶嵌；

同时，它的良好流动性使样品内的孔洞和裂缝充满树脂，它可用于空隙样品。当和真空镶嵌机配套使用时，镶嵌材料将能更好地填充样品内的微孔洞和极细缝隙；

二、 **警告** 请仔细阅读以下事项：

* **必须远离火源；**
* **操作时戴手套；**

三、 技术参数

组 元： 1000ml树脂、300ml固化剂

固化温度： 250C左右的室温或加热

硬化时间： 250C时约20~24小时，

性 能： 完全透明

保 存： 在通风、避光处保存。在200C以下，保质期：二年

镶嵌后的样品： 样品可以切割、研磨、抛光和腐蚀

四、 操作步骤

* 建议样品的镶嵌在抽风厨里进行，操作时，带上橡胶手套；
* 样品在镶嵌前清洗去脂并吹干；
* 混和比：**树脂 : 固化剂= 100：30**（重量比）
* 步骤：

1. 用天平或针筒或量筒提起相应比例的液体注入塑料杯；

2. 用搅拌棒沿顺时针方向搅拌约一分钟左右，以形成混合均匀的可流动的糊状。始终沿顺时针搅拌可减少气泡的产生；

3. 小心地将混合物倾倒在放有样品的冷镶嵌模中；

4. 待镶嵌料完全凝固，将橡皮模外翻，即可把样品从模中取出；

5．两组份在固化前溶于丙酮，可用丙酮进行清洗。